

平成27年度 ナノテクキャリアアップアライアンス
京都大学 MEMS コース《中長期型》

■目的、対象者：

マイクロスケールからナノスケールにおける微細加工技術（フォトリソグラフィ、成膜、エッチング、接合）は、ナノテクノロジーを駆使する MEMS/NEMS、電子デバイス、マイクロ流体デバイスの研究推進には必要不可欠です。

本コースでは、微細加工技術の初心者を対象に、微細加工技術の基本原理を理解すると共にナノテクノロジーハブ拠点の微細加工装置を利用した実習により、微細加工技術全体を総合的に理解し、簡単なデバイスを自分で設計、試作できる技術の習得を目指します。

■募集人数

前期・後期各3名（最大）

■期間

前期：平成27年4月1日（水）～平成27年9月30日（水）

後期：平成27年10月1日（木）～平成28年3月31日（木）

■実施場所

京都大学ナノテクノロジーハブ拠点

京都大学桂キャンパスCクラスター

■内容：

前期・後期のコース開始前、あるいはコース開始後の出来るだけ早い時期に、受講者、本務の指導教員・指導者、技術支援担当者、CUPAL 運営委員による打ち合わせを行い、受講者の専門、ニーズに合わせて、個別に具体的な実施内容、実施形態を決定（オーダーメイドカリキュラム）します。

オーダーメイドカリキュラムは、ナノテクノロジーハブ拠点（ナノハブ拠点）での微細加工装置の操作実習、デバイスの設計・試作トレーニング、京都大学工学研究科の講義聴講（H27年度後期の場合のみ科目等履修生または聴講生として可能）、本務校の授業履修、メーカーでの実習、などのメニューから、適宜組み合わせで作成します。

実施形態は、定期的（毎週、2週間毎、毎月）な実施、集中（1週間、2週間など）した実施、あるいは定期と集中を組み合わせた実施など多様な選択肢に対応します。

■受講料：

アライアンス内の博士課程（後期）学生、若手研究者および研究支援人材：

無料（旅費の補助を予定）

一般 1,000,000円

■連絡先： 京都大学ナノテクノロジーハブ拠点

(kyodai-hub@saci.kyoto-u.ac.jp、電話：075-753-5231)